

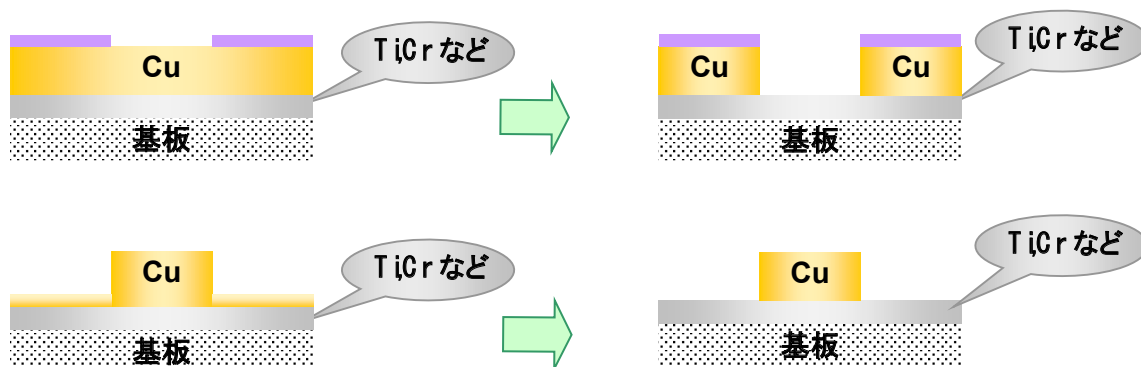
The copper seed layer removal liquid of the printed circuit board

銅選択エッチング液-CS series Copper selective etchant

● 特長

- ① 銅以外の金属との選択エッチング性に優れています。
- ② 過酸化水素タイプなので穏和な条件で銅層をエッチングすることができます。
- ③ 処理温度、処理時間により、エッチング速度のコントロールが可能です。
- ④ 過酸化水素の安定性に優れているので、液管理が容易です。

<用途例>	エッチングする金属	選択性のある金属
	Cu	Ti, Cr など



● 使用条件

	範囲
処理温度	25℃～40℃
処理時間	任意 (Cu 層の厚さにより調整して下さい)
処理方法	浸漬又はスプレー処理

* 処理温度、処理時間によりエッチング速度のコントロールが可能です。

● 銅選択エッチング液-CS series

製品名	特長	高選択性が得られる金属 (溶解しない金属)
銅選択エッチング液 CS	高速で均一なエッチングが可能です	Ti, Cr, Sn, W, Au NiCr, SUS など
銅選択エッチング液 CSD	アンダーカットが少ないのでファインパターンへのエッチングに適しています	Ti, Cr, W, Au NiCr, SUS など
銅選択エッチング液 CSS	金属と選択性に優れており、様々な用途への応用が可能です	Ti, Cr, W, Au, NiCr, SUS, Ni, Sn, など